

Informations de base	
2018/2947(DEA)	Procédure terminée - acte délégué entre en vigueur
DEA - Procédure d'acte délégué	
Exemption relative au plomb dans les soudures visant à réaliser une connexion électrique durable entre la puce et le substrat du semi-conducteur dans les boîtiers de circuits intégrés à puce retournée	
Complétant 2008/0240(COD)	
Subject	
3.40.06 Industries électronique, électrotechnique, TIC, robotique	
3.70.13 Substances dangereuses, déchets toxiques et radioactifs (stockage, transport)	

Portail de documentation			
Commission Européenne			
Type de document	Référence	Date	Résumé
Document de base non législatif	C(2018)07499	16/11/2018	
Document annexé à la procédure	C(2025)5889	25/08/2025	